

北京企学研教育科技有限公司 惠脉智能科技（上海）有限公司

企学研字（2025）14号

首届数字化多轴加工创新智造赛项

技术规程、命题蓝图、评分要点及国际团体标准、金砖工坊、
国际技能护照一体化工作会的报名通知

各相关单位：

为了落实《金砖国家工商理事会年度报告》（2022年-2024年）关于金砖国家未来技能和技术挑战赛；金砖国家未来技能国际训练营；金砖国家未来技能训练基地（金砖工坊）；金砖国家技能护照计划；金砖国家技术对话合作、孵化和创新；金砖国家竞赛、技能和课程国际团体标准制定；金砖国家知识共享计划-金砖大讲堂等相关工作。北京企学研教育科技有限公司和惠脉智能科技（上海）有限公司作为首届数字化多轴加工创新智造赛项的联合承办单位，兹定于6月14日-6月16日在上海电机学院高职学院举办“首届数字化多轴加工创新智造赛项技术平台、命题蓝图、评分要点及国际团体标准、金砖工坊、国际技能护照一体化工作会”。现将有关事宜通知如下：

一、培训及会议内容

第一部分：主报告、签字仪式

1. 2017-2025 金砖国家技能发展与技术创新成果设计与务实合作；
2. 首届数字化多轴加工创新智造赛项知识和技能要求、竞赛任务、命题蓝图、评分要点解读；
3. 金砖国家国际技能竞赛、国际团体技能和技术标准、金砖工坊、国际技能护照等一体化工作介绍；
4. 一带一路暨金砖国家技能发展国际联盟新成员单位签字仪式；
5. 2025 一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛首届数字化多轴加工创新智造赛项决赛承办签字仪式；
6. 走进惠脉智能科技（上海）有限公司学习多轴加工创新智造新技术；

二、参加培训及会议人员

1. 申请一带一路暨金砖国家技能发展国际联盟成员的各相关单位代表。
2. 拟申报 2025 一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛首届数字化多轴加工创新智造赛项决赛承办单位代表。
3. 开设首届数字化多轴加工创新智造赛项相关专业方向负责人、院校领导、系主任、教研室主任，专业教师及社会企事业人员等。
4. 首届数字化多轴加工创新智造赛项专家组成员。
5. 意向参与数字化多轴加工创新智造赛项国际团体标准、金

砖工坊、国际技能护照一体化工作院校的国际处负责人。

三、培训及会议时间、地点

会议时间：6月14日~16日；16日离会

会议地点：上海电机学院高职学院（上海市闵行区江川路690号）

推荐酒店：汉庭（上海交大第五人民医院店·东川路2645号），曼哈顿酒店（上海闵行店·鹤庆路900号5-6号楼）

前台电话：021-64197030（汉庭），021-67281666（曼哈顿）

四、培训及会议费用

培训及会议免费，交通食宿费用自理。

五、其它事宜

1. 参加会议的单位请于2025年6月12日前扫描“会议二维码”提交报名回执信息；



2. 拟加入一带一路暨金砖国家技能发展国际联盟的单位于6月12日前微信扫描下方二维码或电脑登录赛事云平台（<https://c5yun.chinajxedu.com/>）点击右上角“我的->联盟申请”进行线上申报。

六、联系方式

1. 惠脉智能科技（上海）有限公司

联系人：罗明波（18621358992）

联系电话：021-33680988

2. 北京企学研教育科技有限公司

联系人：刘宇同（18600179266）

联系电话：010-82895227



2025年6月3日